

证券代码：603061

证券简称：金海通

**天津金海通半导体设备股份有限公司**  
**投资者关系活动记录表**

编号：2024-006

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input checked="" type="checkbox"/> 现场访谈 <input type="checkbox"/> 其他	<input type="checkbox"/> 线上分析师会议 <input checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input checked="" type="checkbox"/> 线上调研
参与单位名称	线上分析师会议：海通证券、中金公司、天风证券、中邮证券、上海证券、东北证券、华泰证券、山西证券、国金证券、长江证券、国投证券、德邦证券、浙商证券、国联证券、国海证券、开源证券、东吴证券、国泰君安证券、中泰证券、东财证券、华安证券、金股证券、汇丰晋信、国投瑞银基金、昭华基金、光大保德信基金、睿融私募基金、鸿运私募基金、金之灏基金、保银投资、普华投资、理臻投资、智子投资、云杉投资、泽铭投资、明河投资、双木投资、鑫宇投资、丞毅投资、宝源胜知、大家资产、全德学资本、光证资管、敦和资管、朋元资管、前海万方达资管、平安银行、IGWT Investment、果行育德管理咨询（以上排名不分先后） 现场访谈：德邦证券、海通证券 业绩说明会：参与业绩说明会的投资者	
时间	2024年4月28日-2024年4月30日	
地点	线上分析师会议：进门财经、腾讯会议 现场访谈：上海市青浦区嘉松中路2188号 业绩说明会：上证路演中心（ <a href="http://roadshow.sseinfo.com">http://roadshow.sseinfo.com</a> ）	
上市公司接待人员	副总经理兼董事会秘书刘海龙先生	

姓名	
投资者关系活动主要内容介绍	<p style="text-align: center;"><b>一、公司介绍主要内容</b></p> <p>金海通的主营业务为集成电路测试分选机的研发、生产及销售，客户群体涵盖半导体封装测试企业、测试代工厂、IDM 企业（半导体设计制造一体化厂商）、芯片设计公司等。公司产品在集成电路封测行业有较高的知名度和认可度，产品遍布中国大陆、中国台湾、欧美、东南亚等全球市场。</p> <p>公司自成立以来，始终坚持深耕集成电路测试分选机的研发、生产和销售。公司深耕平移式测试分选机领域，产品根据可测试工位、测试环境等测试分选需求分为 EXCEED-6000 系列、EXCEED-8000 系列、EXCEED-9000 系列、SUMMIT 系列、COLLIE 系列、NEOCEED 系列等。</p> <p>公司的核心技术集中于“高速运动姿态自适应控制技术”、“高兼容性上下料技术”、“高精度温控技术”、“芯片全周期流程监控技术”等领域。公司产品的软件定制化程度高，集成程度高，反馈速度快，技术支持响应度好；产品的 UPH（单位小时产出）、Jam rate（故障停机率）、可并行测试最大工位等指标已达到同类产品的国际先进水平。</p> <p style="text-align: center;"><b>二、公司 2023 年年报及 2024 年第一季度业绩概况</b></p> <p>2023 年，全球电子产品市场需求疲软，集成电路行业处于下行周期，半导体封装测试企业、测试代工厂等设备需求趋缓，公司 2023 年实现营业收入 3.47 亿元，较上年同期减少 18.49%。</p> <p>受毛利率较上年同比下降，研发费用、管理费用等费用较上年同比增长等因素影响，2023 年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润 8479.41 万元，较上年同比减少 44.91%。</p> <p>公司销售的测试分选机产品有 EXCEED-6000 系列、EXCEED-8000 系列及其他系列等，各系列产品具有多种型号，同时公司提供了多种选配功能，销售价格存在一定差异；2023 年受市场需求下行等影响，公司产品销售结构较上年发生变化，功能配置较低的机型占销售收入的比重较 2022 年有一定程度的提升；同时，公司部分产品采用委托外</p>

协的方式进行生产加工导致成本略有提高；因此，公司 2023 年毛利率较上年同比下降。

研发方面，2023 年，公司持续增加研发投入，为产品创新和公司竞争力提供保障。2023 年，公司研发费用较上年同比增长 25.09%。同时，公司持续引进研发人员并加强人才培养，2023 年末，公司研发人员数量较 2022 年末增长 20.41%。

产品方面，一方面，公司持续升级现有产品，持续跟进客户需求，不断对现有产品在温度控制、并测工位、芯片尺寸、上下料方式和压力控制等各方面进行技术研发和产品迭代；另一方面，公司也积极布局新产品，公司此前推出的 EXCEED-9000 系列产品是在 EXCEED-6000、EXCEED-8000 系列基础上对整个平台的升级，其中的 EXCEED-9800 系列是针对三温测试需求的升级产品。针对 EXCEED-9800 系列产品，2023 年公司积极推进在广泛的客户端进行试用，积极配合客户的进一步需求。同时，公司也在积极推进适用 Memory 和 MEMS 及专用于先进封装产品的测试分选平台的研发工作。

公司募投项目“半导体测试设备智能制造及创新研发中心一期项目”2023 年内已完成土地使用权购置、筹备开工等相关工作，目前正稳步推进，本项目建设周期 3 年，建成后将进一步增加公司研发及制造等综合竞争力。

市场推广方面，2023 年，公司持续加大市场推广力度，积极拓展境内、境外新客户，与客户保持紧密沟通，积极参加展会等行业相关活动。公司 2023 年度销售费用较上年同期增长 17.48%。同时，公司持续提升自身的客户服务能力，加强境内、境外销售及售后团队管理，以提高客户服务效率，完善客户服务体系。2023 年 6 月，公司启动“马来西亚生产运营中心”项目，该项目拟建立在东南亚地区具有全面服务客户的生产和应用能力的生产运营基地，从而更好地贴近市场和客户、响应客户需求，促进公司稳健经营和持续发展。截至目前，“马来西亚生产运营中心”项目正处于厂房装修阶段。

截至 2023 年年末，公司总资产达 15.85 亿元，较上年末增长 93.97%；净资产为 13.99 亿元，较上年末增长 140.05%。总资产、净资产同比有较大幅度上涨是因为公司于 2023 年 3 月首次公开发行股票并在上海证券交易所上市所导致。

公司 2024 年第一季度，实现营业收入 8856.35 万元，较 2023 年第一季度同比减少 12.79%；较 2023 年第四季度环比增加 12.72%。实现归属于上市公司股东的净利润 1489.26 万元，较 2023 年第一季度同比减少 53.31%，较 2023 年第四季度环比减少 53.57%。

截至 2024 年一季度末，公司总资产达 14.19 亿元，较 2023 年年末减少 10.50%；净资产为 12.54 亿元，较 2023 年年末减少 10.32%。

### 三、调研问答

1、问：公司 2023 年年度主营产品毛利率下降的原因是什么？

答：公司主营产品测试分选机有 EXCEED-6000 系列、EXCEED-8000 系列及其他系列等，各系列产品具有多种型号，同时公司提供了多种选配功能，销售价格存在一定差异；2023 年受市场需求下行等影响，公司产品销售结构较上年发生变化，功能配置较低的机型占销售收入的比重较 2022 年有一定程度的提升；同时，公司部分产品采用委托外协的方式进行生产加工导致成本略有提高；因此，公司 2023 年毛利率较上年同比下降。

2、问：公司对 2024 年毛利率是如何展望的？

答：2024 年，公司将继续坚持“核心产品自主生产、部分成熟产品委托外协的方式进行生产加工”的生产模式。今年，在市场基本面不发生较大变化的情况下，随着公司已开展客户项目的落地，EXCEED-9800 系列三温测试分选机逐步实现量产及积极推进销售，这些因素都会对毛利率产生积极影响。

3、问：请问公司 2024 年产品研发情况以及对市场拓展的计划是怎样的？

答：产品方面，2024 年公司将进一步跟进三温测试设备的定制化需求，持续加强针对新能源、电动汽车及 AI 运算等相关领域芯片测试分选的技术研发，继续加大对适用于 Memory、MEMS 及专用于先进封装产品的测试分选平台的研发力度。同时，公司也将积极布局重点关注的技术方向，截至目前公司已参股投资了 1 家晶圆级测试分选设备公司。

市场方面，2024 年在积极开拓境内市场的同时，公司将重点跟进

境外头部 IDM、OSAT 以及设计公司等头部企业快速迭代的产品及测试分选需求。持续增强公司在境外市场的市占率及单个客户的渗透率。

4、问：订单能见度以及交货周期是如何的？

答：一般情况下，客户会与公司进行持续性的常态化沟通，对公司产品的技术指标及交货周期等进行了解。对于量产机型及标准选配功能，公司具有快速交货能力。基于这种情况，客户通常会在需求相对确定时下单。

5、问：2024 年，公司前十大客户有海外客户吗？

答：有的。公司自成立以来，一直以国际市场需求为导向，坚持“国际化定位”，以技术创新为动力，以成为“全球测试分选行业领先者”为目标，这一定位将在未来长期坚持。

公司目前在马来西亚、新加坡等地设有境外经营主体或办公室等。在国际市场战略的背景下，公司境内经营主体协同境外经营主体或办公室面向半导体产业发达的国家和地区进行持续性、常态化的市场开拓及售后服务。

6、问：一般的测试分选机能在客户端使用多久？

答：公司的设备是平台型设备，设备在正常使用和维护状态下，目前最长使用期限记录已超过 10 年。

一方面，随着测试代工企业芯片产品测试需求的不断变化（如芯片封装形式、应用场景）和对测试效率要求的不断提升，既有设备的功能（同测数量、提供三温测试等）与性能（UPH、Jam rate 等）不再能满足客户多种多样的迭代测试需求时，则会出现厂商购置新设备的情况。分选机大的技术迭代周期大概在 3-5 年，客户是否会根据技术迭代进行购置，需结合客户产品及市场定位等具体情况判断。

而另一方面，IDM 企业相较于测试代工企业，其芯片产品测试需求及产能规划相对稳定，对设备的需求更具规划性，实际使用设备的年限相对更长。而随着使用时间超过质保期后，部分原厂不再提供更换零部件等售后服务时，厂商会考虑购置新设备。

7、问：能给大家介绍一下先进封装芯片适用于重力式、转塔式、

平移式三种测试分选机的情况吗？

答：重力式测试分选机是芯片靠自身重力和外部压缩空气在导轨中传送来实现分选过程中的位移，适用于有引脚、有一定重量的封装芯片（如 DIP、SOIC 等）。

转塔式测试分选机是由主转盘内的直驱电机作为动力来源将芯片转动到测试工位上从而实现分选过程中的位移，适用于体积小、重量小的芯片或分立器件。

平移式测试分选机采用机械臂真空吸取芯片、运输芯片，同测数量多，适用于多种封装类型的芯片。

公司的平移式测试分选机主要适用于 QFN（四边扁平无引脚封装），QFP（方型扁平式封装），BGA（球栅阵列封装），LGA（栅格阵列封装），PLCC（塑料有引线片式载体封装），PGA（插针网格阵列封装），CSP（芯片级尺寸封装），TSOP（薄型小尺寸封装）等封装形式的芯片。据公司了解，目前采用先进封装的芯片，其成品大多为可适用于平移式测试分选机的封装体的形式。

#### 四、业绩说明会问答

1、问：ESG 话题现在受到股民的广泛关注，很多评级机构也对各个公司进行了评分。我想知道贵公司在提升 ESG 表现方面有无改进措施？

答：尊敬的投资者，您好！公司高度重视在公司治理、环境保护和社会责任等方面履行上市公司相关责任。感谢您的关注！

2、问：请问贵公司的芯片设计测试分选机销售收入的毛利率相当高，贵公司在国内的竞争对手有哪些企业？贵公司在该领域内有哪些竞争优势？

答：尊敬的投资者，您好！

公司主营业务为集成电路测试分选机的研发、生产及销售。集成电路测试分选机属于集成电路专用设备领域的测试设备。

目前，全球集成电路测试分选机行业内，除公司外，主要有美国科休半导体公司（Cohu, INC.）、日本精工爱普生公司（Seiko Epson

Corporation)、日本爱德万测试集团(Advantest Corporation)、中国台湾鸿劲精密股份有限公司、杭州长川科技股份有限公司等企业。

公司自成立以来深耕集成电路测试分选机领域,经过多年的研发和创新,公司产品的主要技术指标及功能已达到同类产品国际先进水平。公司的测试分选机涉及到光学、机械、电气一体化的创新集成,可以精准模拟芯片真实使用环境,并实现多工位并行测试,其UPH(单位小时产出)最大可达到13,500颗, Jam rate(故障停机率)低于1/10,000,可测试芯片尺寸范围可涵盖2\*2mm~110\*110mm,可模拟-55℃~155℃等各种极端温度环境。公司的核心技术集中于“高速运动姿态自适应控制技术”、“三维精度位置补偿技术”、“压力精度控制及自平衡技术”、“运动轨迹优化技术”、“高速高精度多工位同测技术”、“高兼容性上下料技术”等精密运动控制领域,及“高精度温控技术”、“芯片全周期流程监控技术”、“高精度视觉定位识别技术”等,科技创新能力突出,具备较强的核心竞争力。

感谢您的关注!

3、问:请问公司在国内行业地位如何?同类上市公司有哪几家?

答:尊敬的投资者,您好!

公司主营业务为集成电路测试分选机的研发、生产及销售。集成电路测试分选机属于集成电路专用设备领域的测试设备。

公司自成立以来深耕集成电路测试分选机领域,经过多年的研发和创新,公司产品的主要技术指标及功能已达到同类产品国际先进水平。

公司所在行业是充分竞争的全球化市场。目前,全球集成电路测试分选机行业内,除公司外,上市公司主要有美国科休半导体公司(Cohu, INC.)、日本精工爱普生公司(Seiko Epson Corporation)、日本爱德万测试集团(Advantest Corporation)、杭州长川科技股份有限公司等企业。其中,杭州长川科技股份有限公司是A股上市公司。

感谢您的关注!

4、问:公司有哪些技术优势,目前的市场表现如何?

	<p>答：尊敬的投资者，您好！</p> <p>公司自成立以来深耕集成电路测试分选机领域，经过多年的研发和创新，公司产品的主要技术指标及功能已达到同类产品国际先进水平。</p> <p>公司的测试分选机涉及到光学、机械、电气一体化的创新集成，可以精准模拟芯片真实使用环境，并实现多工位并行测试，其 UPH（单位小时产出）最大可达到 13,500 颗，Jam rate（故障停机率）低于 1/10,000，可测试芯片尺寸范围可涵盖 2*2mm~110*110mm，可模拟-55℃~155℃等各种极端温度环境。公司的核心技术集中于“高速运动姿态自适应控制技术”、“三维精度位置补偿技术”、“压力精度控制及自平衡技术”、“运动轨迹优化技术”、“高速高精度多工位同测技术”、“高兼容性上下料技术”等精密运动控制领域，及“高精度温控技术”、“芯片全周期流程监控技术”、“高精度视觉定位识别技术”等，科技创新能力突出，具备较强的核心竞争力。</p> <p>公司的产品在集成电路封测行业有较高的知名度和认可度，产品遍布中国大陆、中国台湾、东南亚、欧美等全球市场。</p> <p>感谢您的关注！</p>
附件清单 (如有)	无
风险提示	以上如涉及公司所处行业发展趋势、公司发展规划等相关内容，不代表公司或公司管理层对行业发展、公司发展或业绩的预测和承诺，不构成公司或公司管理层对投资者的实质性承诺，敬请广大投资者注意投资风险。
日期	2024 年 4 月 30 日